

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2026-072

北京赛微电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐永文	孙玉华	
电话	010-82252103	010-82251527	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼		北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼
电子信箱	ir@smeic.com		ir@smeic.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	178,373,115.82	570,095,783.13	-68.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,702,213,961.27	-650,333.36	415,612.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-379,251,813.20	-19,465,657.87	-1,848.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,503,842.57	165,802,553.59	-166.04%
基本每股收益（元/股）	3.6905	-0.0009	410,155.56%
稀释每股收益（元/股）	3.6905	-0.0009	410,155.56%
加权平均净资产收益率	34.07%	-0.01%	34.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	11,597,205,730.48	8,939,422,428.40	29.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,039,863,671.86	6,734,386,456.42	34.23%

注：上述表格中归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益、稀释每股收益本报告期比上年同期增减不一致，系因小数点四舍五入导致。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,283	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	21.04%	154,023,719	134,307,539	质押	26,150,000
					冻结	11,843,479
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.94%	21,499,461	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	11,423,578	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.56%	4,123,974	0	不适用	0
江西莹光化工有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,020,000	0	不适用	0
#肖爱军	境外自然人	0.38%	2,818,994	0	不适用	0
#宋天峰	境内自然人	0.33%	2,411,900	0	不适用	0
吕银用	境外自然人	0.33%	2,406,600	0	不适用	0
#肖晓勇	境内自然人	0.33%	2,391,200	0	不适用	0
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	0.33%	2,390,321	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		肖爱军通过普通证券账户持有 15,994 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,803,000 股，实际合计持有 2,818,994 股；宋天峰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,411,900 股，实际合计持有 2,411,900 股；肖晓勇通过普通证券账户持有 5,600 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,385,600 股，实际合计持有 2,391,200 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

（一）整体经营情况概述

报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（机电系统），并持续为下一步的产能扩充及爬坡做好准备；同时依托并购展诚科技形成的业务基础，持续强化并夯实 IC 设计服务能力。

对于北京亦庄 MEMS 量产线，报告期内继续处于产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，北京亦庄 MEMS 量产线业务收入实现增长。但由于北京亦庄 MEMS 量产线研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，北京亦庄 MEMS 量产线仍处于亏损状态。

对于 IC 设计服务，报告期内，展诚科技继续保持良性发展，业务稳步推进，持续巩固拓展客户，实现盈利。

报告期内，公司及相关子公司基于存量仍适度开展半导体设备业务，贡献了一定的营业收入，但由于缺乏大客户销售，且国内半导体设备市场竞争加剧，公司 2026 年上半年半导体设备业务收入较上年同期大幅下降。

与此同时，报告期内公司管理费用、销售费用较上年同期大幅下降，财务费用较上年同期基本持平；研发费用继续处于较高投入水平。

报告期内，公司实现营业收入 17,837.31 万元，较上年同期大幅下降 68.71%；实现营业利润 310,886.56 万元，较上年同期大幅增长 4,521.59%；实现利润总额 310,886.77 万元，较上年同期大幅增长 4,521.60%；实现净利润 267,512.45 万元，较上年同期大幅增长 9,360.48%；归属于上市公司股东的净利润 270,221.40 万元，较上年同期大幅增长 415,612.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,925.18 万元，较上年同期大幅下降 1,848.31%。

报告期内，公司基本每股收益 3.6905 元，较上年同期大幅增长 410,155.56%；加权平均净资产收益率 34.07%，较上年同期优化 34.08%（绝对数值变动），主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 415,612.12%。

本报告期末，公司总资产 1,159,720.57 万元，较期初上升 29.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 903,986.37 万元，股本 732,213,134.00 元，归属于上市公司股东的每股净资产 12.35 元，较期初上升 34.24%。

公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Silex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Silex 不再纳入公司合并报表范围，上述股权交易是本报告期公司营业收入大幅下降的主要原因。报告期内，瑞典 Silex 在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市，公司在瑞典 Silex 上市的同时转让其部分股权；瑞典 Silex 上市后，公司对持有瑞典 Silex 的剩余股权采用公允价值计量，由股权转让及公允价值变动产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。报告期内，非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为 308,146.58 万元（主要影响因素为转让瑞典 Silex 部分股权及其剩余股权的公允价值变动），上年同期非经常性损益对当期归母净利润的影响为 1,881.53 万元（主要影响因素为政府补助）。

（二）主要业务情况

1、MEMS 纯代工业务发展情况

报告期内，公司 MEMS 业务收入下降，主要系公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Silex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Silex 不再纳入公司合并报表范围；另一方面公司北京亦庄 MEMS 量产线的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆代工品类持续增加，2026 年上半年北京亦庄 MEMS 量产线工厂的收入比上年同期有所增加，但整体收入规模仍较小。

报告期内，公司 MEMS 业务实现收入 7,897.15 万元，较上年同期大幅下降 85.17%；其中，MEMS 晶圆制造实现收入 4,673.83 万元，较上年同期大幅下降 84.90%，MEMS 工艺开发实现收入 3,223.32 万元，较上年同期大幅下降 85.55%，上述变化的主要原因是：瑞典 Silex 不再纳入公司合并报表范围。与此同时，由于北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，营收规模体量以及量产产品类别仍相对较少，但持续累积各领域客户及晶圆产品类别。

报告期内，公司 MEMS 业务的综合毛利率为 20.44%，较上年同期下降 19.03%；其中 MEMS 晶圆制造毛利率为 6.50%，较上年同期下降 30.62%，MEMS 工艺开发毛利率为 40.66%，较上年同期下降 2.07%，上述变化的主要原因是：公司于 2025 年 7 月出售瑞典 Silex 控制权，瑞典 Silex 不再纳入公司合并报表，而北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，收入规模较小，加之受复杂国际形势、市场环境等因素影响，上游原材料价格上升，综合导致 MEMS 业务毛利率下降。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充的产线产能，公司积极开拓全球市场，并积极承接 MEMS 工艺开发及晶圆制造订单，持续服务于包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、高频通信、ICT 等厂商以及通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子等各细分领域的领先企业。

报告期内，公司北京亦庄 MEMS 量产线持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并适时逐步扩充产能。公司虽已于 2025 年 7 月完成瑞典 Silex 控制权出售的交割，但随着北京亦庄 MEMS 量产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的怀柔 MEMS 中试线布局，公司仍拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面可以实现协同互补，公司有望在纯 MEMS 代工领域仍保持重要地位。

2、IC 设计服务业务发展情况

报告期内，展诚科技实现营业收入 8,752.05 万元，保障提升 IC 设计服务业务基本盘的同时，推进了 EDA 软件开发。报告期内，展诚科技紧抓算力及 AI 芯片发展的重要机遇期，优化自身技术，夯实绑定大客户战略，大力开发新客户，实现了技术优化升级与包括海外市场的业务开拓，并提前布局 3nm 以下技术储备与积累。同时，展诚科技积极延伸业务赛道，力争细分领域的突破，并不断打造自身在不同芯片领域从架构设计到版图验证的一站式服务能力和全方位服务体系，关注和兼容国际主流技术、工具、格式，积极捕捉商业机遇，为将来助力客户降低研发成本、缩短上市周期做好了扎实准备。报告期内展诚科技各业务模式的发展情况如下：

（1）off-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 off-site 模式依托远程网络专业工具、安全远程协作体系的完善和普及，借助标准化的设计流程、跨地域的资源整合能力，在芯片设计、验证、标准化 IP 开发与验收、设计数据校验检查等项目流程中持续优化运营效率，有效降低了远程协作的沟通成本。off-site 模式是展诚科技服务众多客户、承接批量标准化需求的重要模式。

（2）on-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 on-site 模式持续深化场景化适配能力，针对客户先进工艺节点芯片设计、高复杂度混合模块等对实时协同、工艺深度对接要求高的需求，进一步强化驻场团队的专业配比度，提升快速响应速度，通过与客户的无缝联动，在项目中实现了高效协作和高质量交付。on-site 模式是展诚科技 IC 设计服务业务发展的重要模式。

（3）odc 模式发展情况

报告期内，在 odc 离岸开发中心模式方面，展诚科技搭建专属化、定制化的离岸团队，推进规模化落地与精细化运营，围绕芯片设计客户的长期持续性需求，实现了团队与客户设计规范、工艺要求、工具链的深度适配，同时展诚科技通过建立远程管理体系、人才培养机制与数据安全防护体系，有效平抑了高端人才稀缺等问题，初步形成了成本优势与交付效率的双协同。

3、研发情况

报告期内，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 纯代工业务及 IC 设计服务业务均属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，同时也需要公司进行重点、持续的研发投入。2026 年上半年，公司共计投入研发费用 19,899.89 万元，继续保持了较高的投入强度，在收入因瑞典 Sillex 出表 2026 年上半年大幅下滑的情况下，研发费用占本期营业收入比例 111.56%。

4、投融资情况

报告期内，公司为实现产业目标、把握合作机遇、更好地服务于 MEMS 主业的发展，基于过往已有布局、根据长期发展战略继续开展投融资活动：（1）股权投资方面，根据公司业务发展战略和规划，公司进一步提高了对赛莱克斯北京、海创微元的持股比例，投资 CompoundTek 部分股权，并小比例参与投资了多家半导体产业链相关公司；（2）股权转让方面，公司转让瑞典 Sillex 部分股权，同时仍保留部分少数股权；（3）产业基金方面，持续推动相关合作产业基金在智能传感领域的项目投资，继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金等的投资与投后情况；（4）融资租赁方面，赛莱克斯北京、赛积国际继续执行相关融资租赁交易；（5）银行授信及并购贷款方面，公司及子公司根据经营发展中的资金需求，积极向相关银行申请综合授信额度及并购贷款，扩大资金使用空间，降低财务资金成本。